



## 平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年11月7日

上場取引所 東

上場会社名 アピックヤマダ株式会社  
コード番号 6300 URL <http://www.apicyamada.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 押森広仁  
問合せ先責任者 (役職名) 取締役企画部長 (氏名) 小出 篤

TEL 026-275-2111

四半期報告書提出予定日 平成26年11月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26年9月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期第2四半期	5,491	33.3	123	—	127	—	136	—
26年3月期第2四半期	4,118	△17.5	△358	—	△397	—	△229	—

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 76百万円 (602.4%) 26年3月期第2四半期 10百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
27年3月期第2四半期	10.98	—
26年3月期第2四半期	△18.45	—

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27年3月期第2四半期	11,902	4,074	34.2	327.96
26年3月期	10,689	3,997	37.4	321.75

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 4,074百万円 26年3月期 3,997百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
26年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
27年3月期	—	0.00	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	11,140	22.5	120	—	120	—	105	—	8.45

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

27年3月期2Q	12,969,000 株	26年3月期	12,969,000 株
----------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

27年3月期2Q	545,974 株	26年3月期	544,498 株
----------	-----------	--------	-----------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

27年3月期2Q	12,423,345 株	26年3月期2Q	12,425,407 株
----------	--------------	----------	--------------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法)

当社は、平成26年11月21日(金)にアナリスト向け説明会を開催する予定です。当日使用する決算説明会資料につきましては、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	3
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	3
3. 継続企業の前提に関する重要事象等 .....	3
4. 四半期連結財務諸表 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間 .....	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	9
(継続企業の前提に関する注記) .....	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	9
(セグメント情報等) .....	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、中国をはじめとする新興国の成長鈍化が見られたものの、先進国を中心に穏やかな回復基調が続きました。一方、我が国においては、消費税率アップの前の駆け込み需要の反動減がみられましたが個人消費や設備投資などに持ち直しの動きが見られ、基調的には緩やかな回復傾向となりました。

当社の需要先である半導体業界においては、スマートフォンなどの携帯情報端末関連が安定的に推移し、パワー半導体及びLEDなど省エネ関連向け、自動車向けも堅調に推移しました。

電子部品組立装置につきましては、前期より発売開始したモールド装置「GTM-Xシリーズ」が合理化、増産及び新パッケージ量産用として好評をいただいております。また、より複雑かつ高度な実装品を伴う高付加価値パッケージの量産用として、当社が開発したモールド金型のキャビティ(Cavity:製品形状に合わせた凹形状の部品)の深さを任意に設定できる「VCH金型 (Variable Cavity Height)」が高い評価をいただき、積極的な拡販を行い、先端パッケージの量産に採用されました。

また、電子部品のLEDプリモールド基板については市場の要求に応えるため、順次生産能力を拡大してまいりました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は5,491百万円(前年同四半期比33.3%増)、営業利益は123百万円(前年同四半期は営業損失358百万円)、経常利益は127百万円(前年同四半期は経常損失397百万円)、四半期純利益は136百万円(前年同四半期は四半期純利益損失229百万円)となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

## ①電子部品組立装置

電子部品組立装置の受注環境につきましては、半導体後工程は新規パッケージ向けをはじめ合理化、増産向けとして設備投資に動きが見られ、自動車及びLED関連向けなどにつきましても堅調に推移いたしました。

この結果、売上高は3,605百万円(前年同四半期比34.8%増)、セグメント利益は496百万円(前年同四半期はセグメント損失97百万円)となりました。

## ②電子部品

主力の一般半導体及びLED向けのリードフレーム等の製造につきましては、低価格要求が強まり厳しい状況で推移しました。また、新規事業として取り組んできましたLEDプリモールド基板事業につきましては、前期第4四半期より市場が急速に立ち上り、受注も好調に推移しました。一方で市場の増産要求に応えるため生産能力の増強を行う中で生産の立上げと安定化に手間取り利益を圧迫しました。

この結果、売上高は1,553百万円(前年同四半期比31.9%増)、セグメント損失は108百万円(前年同四半期はセグメント利益27百万円)となりました。

## ③その他

その他につきましては、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の販売であります。リードフレームを使用する半導体の設備投資につきましては慎重な状況が継続しておりますが、リード加工金型に関しては半導体後工程の投資環境が好転した影響もあり改善基調で推移しました。

この結果、売上高は333百万円(前年同四半期比25.5%増)、セグメント利益は28百万円(前年同四半期比181.0%増)となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

## ①資産、負債及び純資産の状況

## (資産)

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、11,902百万円(前連結会計年度末は10,689百万円)となり、前連結会計年度末と比較して1,212百万円増加いたしました。これは主に、売掛金及びたな卸資産の増加によるものであります。

## (負債)

当第2四半期連結会計期間末における負債合計は、7,828百万円(前連結会計年度末は6,692百万円)となり、前連結会計年度末と比較して1,136百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び短期借入金の増加によるものであります。

## (純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は、4,074百万円(前連結会計年度末は3,997百万円)となり、前連結会計年度末と比較して76百万円増加いたしました。これは主に四半期純利益の計上による利益剰余金の赤字幅の減少によるものであります。

なお、これらの要因により、自己資本比率は34.2%（前連結会計年度末は37.4%）となりました。

## ②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較して795百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には2,112百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、資金は828百万円の減少（前年同期間は49百万円の増加）となりました。これは主に好調な受注を背景に売上債権及びたな卸資産が増加したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、資金は177百万円の減少（前年同期間は237百万円の増加）となりました。これは主にLEDブリモールド基板事業を中心に生産能力を拡大するための有形固定資産の取得によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、資金は215百万円の増加（前年同期間は184百万円の減少）となりました。これは主に短期借入金増加によるものであります。

## （3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

半導体後工程の設備投資が当初の想定より活発であったことから、第2四半期累計期間の受注高は、主に第1四半期を中心に計画を上回るとともに、売上高は第2四半期累計期間業績予想を上回る見込みとなりました。また、比較的利益率の高い物件が売上計上となり、第2四半期累計期間の利益率が改善し、各損益につきましても同予想から修正の見込みとなりました。このような状況を踏まえ、第2四半期累計期間の連結及び個別の業績予想の見直しを行い、平成26年10月28日に第2四半期累計期間の業績予想の修正の公表をいたしました。

なお、通期業績予想につきましては、今後の受注環境等不透明な要素が多いため、平成26年5月14日公表の通期業績予想は修正せず、今後の市況や業績動向等を踏まえ、修正が必要と判断した場合は速やかに開示いたします。

## 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

### （1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

### （2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

なお、当該変更による四半期連結財務諸表への影響額はありません。

## 3. 継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは前連結会計年度において3期連続で多額の営業損失を計上したことにより、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しております。しかしながら下記のとおり当該事象または状況を解消するために対応策をとっており、この状況は解消できるものと判断しております。

当社グループは、平成24年度から3年間を対象とした事業構造改革・生産改革・営業改革の3つの改革（Innovation 3）を柱とした「中期経営計画」を策定し、諸施策を実行してまいりました。

この中期経営計画は、①半導体市場において劇的な環境変化に対応できる企業体質を構築し、新たな価値の創出により海外市場を中心にシェアの拡大を図ること、②シリコンサイクルに影響される事業形態からの脱却を目指し、新技術の開発を推進し新たな市場への参入と早期に収益化を図ることを目的として策定いたしました。当社グループは、この中期経営計画の着実な実現をとおして、既存の半導体事業の強化と新規事業の拡大を図り、これによる経営基盤の強化を強い決意で取組んでおります。

また、財務面に関しましては、当面の事業遂行上、十分な手元資金を有しておりますが、引き続きメインバンク等との良好な関係を維持し、安定的かつ弾力的な資金調達を行っていく所存であります。

4. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	2,907,376	2,112,094
受取手形及び売掛金	2,506,853	3,423,752
商品及び製品	505,990	613,291
仕掛品	1,022,537	1,811,007
原材料及び貯蔵品	222,777	200,095
その他	162,259	277,999
貸倒引当金	△5,819	△1,513
流動資産合計	7,321,975	8,436,727
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,019,979	1,006,178
機械装置及び運搬具(純額)	390,141	448,586
土地	511,589	511,589
その他	177,731	270,956
有形固定資産合計	2,099,442	2,237,310
無形固定資産	105,934	95,938
投資その他の資産		
その他	1,168,090	1,138,110
貸倒引当金	△5,522	△5,522
投資その他の資産合計	1,162,567	1,132,587
固定資産合計	3,367,944	3,465,836
資産合計	10,689,919	11,902,563
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,855,581	2,644,453
短期借入金	2,798,000	3,138,000
1年内返済予定の長期借入金	212,688	212,088
未払法人税等	14,847	13,754
賞与引当金	68,895	93,925
製品保証引当金	18,910	26,908
その他	355,340	397,656
流動負債合計	5,324,262	6,526,785
固定負債		
長期借入金	394,946	289,202
退職給付に係る負債	795,363	765,866
その他	177,728	246,496
固定負債合計	1,368,037	1,301,565
負債合計	6,692,300	7,828,350

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	5,837,500	5,837,500
利益剰余金	△1,403,913	△1,267,468
自己株式	△100,161	△100,389
株主資本合計	4,333,424	4,469,642
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5,080	12,678
為替換算調整勘定	△296,499	△368,493
退職給付に係る調整累計額	△44,386	△39,613
その他の包括利益累計額合計	△335,805	△395,429
純資産合計	3,997,619	4,074,213
負債純資産合計	10,689,919	11,902,563

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
売上高	4,118,426	5,491,384
売上原価	3,384,854	4,258,557
売上総利益	733,572	1,232,827
販売費及び一般管理費	1,092,522	1,109,006
営業利益又は営業損失(△)	△358,950	123,821
営業外収益		
受取利息及び配当金	3,137	2,204
為替差益	3,833	27,984
受取技術料	16,100	10,052
その他	28,586	40,234
営業外収益合計	51,657	80,475
営業外費用		
支払利息	37,448	35,370
持分法による投資損失	51,299	21,086
その他	1,572	20,312
営業外費用合計	90,319	76,769
経常利益又は経常損失(△)	△397,612	127,527
特別利益		
固定資産売却益	171,475	12,331
特別利益合計	171,475	12,331
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△226,136	139,858
法人税、住民税及び事業税	3,090	4,033
法人税等調整額	—	△620
法人税等合計	3,090	3,413
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△229,227	136,445
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△229,227	136,445

(四半期連結包括利益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	△229,227	136,445
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,581	7,597
為替換算調整勘定	141,217	△37,992
退職給付に係る調整額	—	4,772
持分法適用会社に対する持分相当額	97,364	△34,002
その他の包括利益合計	240,163	△59,624
四半期包括利益	10,936	76,821
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	10,936	76,821

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△226,136	139,858
減価償却費	136,677	139,676
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△439	△4,305
賞与引当金の増減額(△は減少)	15,650	25,562
製品保証引当金の増減額(△は減少)	△1,081	7,998
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△23,057	—
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	—	△24,723
受取利息及び受取配当金	△3,137	△2,204
支払利息	37,448	35,370
為替差損益(△は益)	△35,042	△7,935
持分法による投資損益(△は益)	51,299	21,086
固定資産売却損益(△は益)	△171,475	△12,331
固定資産除却損	198	184
売上債権の増減額(△は増加)	△484,893	△868,683
たな卸資産の増減額(△は増加)	△325,748	△887,682
未収消費税等の増減額(△は増加)	△1,997	△83,608
その他の流動資産の増減額(△は増加)	14,185	△4,357
仕入債務の増減額(△は減少)	798,315	795,481
その他の負債の増減額(△は減少)	△34,390	△28,893
その他	2,112	—
小計	△251,512	△759,507
利息及び配当金の受取額	6,999	2,204
利息の支払額	△37,527	△35,756
法人税等の支払額	△12,569	△35,880
法人税等の還付額	216	251
保険金の受取額	343,919	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,527	△828,687
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△40,239	△190,050
有形固定資産の売却による収入	277,902	40,778
無形固定資産の取得による支出	△430	△3,260
その他の支出	△745	△25,956
その他の収入	1,426	518
投資活動によるキャッシュ・フロー	237,913	△177,969
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△2,000	340,000
長期借入金の返済による支出	△162,044	△106,344
自己株式の取得による支出	△92	△227
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△19,886	△17,653
財務活動によるキャッシュ・フロー	△184,023	215,775
現金及び現金同等物に係る換算差額	89,334	△4,399
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	192,752	△795,281
現金及び現金同等物の期首残高	3,217,351	2,907,376
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,410,103	2,112,094

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注)	合計
	電子部品 組立装置	電子部品	計		
売上高					
外部顧客への売上高	2,675,264	1,177,634	3,852,899	265,527	4,118,426
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,646	—	1,646	12,943	14,590
計	2,676,910	1,177,634	3,854,545	278,471	4,133,017
セグメント利益又は損失(△)	△97,333	27,048	△70,285	10,014	△60,270

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リード加工金型及びリードフレームプレス用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	△70,285
「その他」の区分の利益	10,014
セグメント間取引消去	78
全社費用(注)	△298,757
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△358,950

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ当第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注)	合計
	電子部品 組立装置	電子部品	計		
売上高					
外部顧客への売上高	3,605,122	1,553,151	5,158,274	333,110	5,491,384
セグメント間の内部売上高又は振替高	76,730	3,376	80,106	21,378	101,484
計	3,681,853	1,556,527	5,238,380	354,488	5,592,869
セグメント利益又は損失(△)	496,110	△108,489	387,621	28,140	415,761

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リード加工金型及びリードフレームプレス用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	387,621
「その他」の区分の利益	28,140
セグメント間取引消去	—
全社費用(注)	△291,940
四半期連結損益計算書の営業利益	123,821

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  
該当事項はありません。